

パワー半導体向け SiC 材料について Infineon Technologies との提携関係を強化

株式会社レゾナック（社長：高橋 秀仁）は、パワー半導体分野におけるグローバル企業である Infineon Technologies AG（ドイツ、以下、インフィニオン社）とこの度、SiCパワー半導体に使用されるSiC材料について、新たな複数年の供給・協力契約を締結し、2021年に締結した販売および共同開発契約^{*1} を補完・拡大することで提携関係を強化します。

本提携によりインフィニオン社の有する幅広いパワー半導体製品への採用拡大が期待でき、当社は150mm（6インチ）の供給に加え、200mm（8インチ）の製品供給を計画しています。また当社はインフィニオン社との開発活動を拡充することでSiCエピウエハーの技術改善、品質向上を加速します。両社の提携強化は、新しい半導体材料であるSiC市場の急速な成長とSiCパワー半導体サプライチェーンの安定化に貢献するものです。

レゾナックグループは「共創型化学会社」として、グローバル社会の持続可能な発展への貢献を目指し、エネルギー効率化を実現するSiCエピウエハーを次世代事業と位置付けて注力しています。今後も、“ベスト・イン・クラス”をモットーに、高性能で高い信頼性の製品を供給することで、SiCパワー半導体の普及に貢献します。

^{*1} 2021年5月6日発表「パワー半導体向けSiCエピタキシャルウエハーについて Infineon Technologiesと販売および共同開発契約を締結」

以上

なお、インフィニオン社からリリースされたステートメントを添付いたします。

Infineon and Resonac announce the expansion of their cooperation and a new multi-year agreement for delivery of silicon carbide (SiC) materials

Munich, Germany – 12 January 2023 – Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) is extending its cooperation with silicon carbide (SiC) suppliers. The German-based

semiconductor manufacturer has signed a new multi-year-supply and cooperation agreement with Resonac Corporation (formerly Showa Denko K.K.), complementing and expanding the announcement of 2021. The new set of contracts will deepen the long-term partnership on SiC material. According to the agreement, Resonac will supply Infineon with SiC materials for the production of SiC semiconductors, covering a double-digit share of the forecasted demand for the next decade. While the initial phase focuses on 6" SiC material supply, Resonac will also support Infineon's transition to 8" wafer-diameter during the later years of the agreement. As part of the cooperation, Infineon will provide Resonac with intellectual property relating to SiC material technologies. The Infineon - Resonac partnership contributes to supply chain stability and will support the rapid growth of the emerging semiconductor material SiC.

"The demand for SiC is growing rapidly and we are preparing for this development with a significant expansion of our manufacturing capacities," said Angelique van der Burg, Chief Procurement Officer at Infineon. "We are pleased to deepen our collaboration with Resonac and strengthen the partnership between our two companies."

"The business opportunities in the area of renewable energy generation and storage, electromobility and infrastructure are enormous for the years to come. Infineon is doubling down on its investments into SiC technology and product portfolio, to proliferate the most comprehensive product offering to its customers. We are very happy that our partnership with Resonac will strongly support our market-leading position," said Peter Wawer, President of Infineon's Industrial Power Control division.

"We are pleased to team-up with Infineon as a global leader in power semiconductors in order to meet the growing demand for SiC in the years to come. We will continuously improve our Best-in-Class SiC material and develop the next generation of 8" wafer technology. We value Infineon as an excellent partner in this regard," said Jiro Ishikawa, Executive Adviser of Device Solutions Business Unit at Resonac.

Infineon is currently expanding its SiC manufacturing capacity in order to reach a market share of 30 percent by the end of the decade. Infineon's SiC manufacturing capacity is about to increase tenfold by 2027. A new plant in Kulim is scheduled to start production in 2024. Today, Infineon already provides SiC semiconductors to more than 3,600 customers worldwide.

About Infineon

Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and IoT. Infineon

drives decarbonization and digitalization with its products and solutions. The company has around 56,200 employees worldwide and generated revenue of about €14.2 billion in the 2022 fiscal year (ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol: IFNNY).

Further information is available at www.infineon.com

This press release is available online at www.infineon.com/press

Follow us: [Twitter](#) - [Facebook](#) - [LinkedIn](#)

【レゾナックグループについて】

レゾナックグループは、2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。

半導体・電子材料の売上高は、全体の3割にあたる約4,000億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界No.1の企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistryの「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 広報グループ 03-5470-3235